南京大学 电子科学与工程学院 全日制统招本科生 《半导体物理与器件》期末考试试卷 【参考答案】

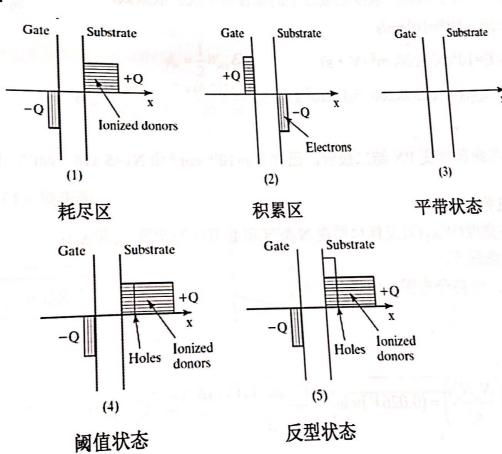
任课教师姓名: 刘斌,叶建东

一、(12分)解释名词

- 1、态密度
- 2、平均自由时间
- 3、雪崩击穿

本题得分

- 4、肖特基接触
- 5、光伏电池
- 6. MOS 电容衬底为 N型,请在下图中(1)-(5)分别标出 (a)平带状态、(b)积累区、(c) 耗 尽区、(d)阈值状态和(e)反型状态
- 1. 态密度: 在单位体积的半导体内,能量范围在 E-E+dE 之间的能态数
- 2. 平均自由时间:载流子两次碰撞间的平均时间
- 3. 雪崩击穿: PN 结反向偏压的情况下,载流子浓度与反向电流急剧增大,最终形成反 向击穿的现象
- 4. 肖特基接触:金属与半导体接触,在界面处半导体的能带弯曲,形成肖特基势垒的 一类接触
- 5. 光伏电池: 与 PN 结的结构类似,能够将太阳能转化为电能,又称太阳能电池。
- 6.



2:

二、(12分) 一硅晶掺入每立方厘米 10¹⁶个砷原子, 求室温下 300K 的载流子被 米能级,并将计算的结果描绘在能带图中,标出 Ec, Ev, EF, Ei 的相对位 本题得分 $n_i=9.65 \times 10^9/\text{cm}^3$

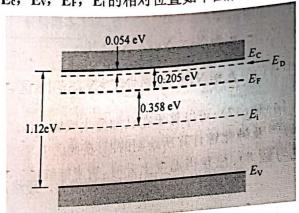
求解: n=N_d=10¹⁶cm⁻³

 $p=n_i^2/N_D= (9.65x10^9)^2/10^{16}cm^{-3}=9.3x10^3cm^{-3}$

 $E_{C}-E_{F}=kTln(N_{C}/N_{D})=0.0259ln(2.86x10^{19}/10^{16})eV=0.205eV$

 $E_F - E_i = kT ln(n/n_i) = kT ln(N_D/n_i) = 0.0259 ln(10^{16}/9.65 \times 10^9) eV = 0.358 eV$

Ec, Ev, E_F, E_i 的相对位置如下图所示



三、(12分)少数载流子(空穴)于某一点注入一个均匀的 n 型半导体 中,施加一个 50V/cm 的电场于其样品上,且电场在 100μs 内将这 些少数载流子移动了1cm,求少数载流子的漂移速率及扩散系数。

本题得分

求解: V_p=1/100x10⁻⁶=10⁴cm/s

$$\mu_p = V_p/E = 10^4/50 = 200 \text{cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$$

 $D_p = (kT/q)\mu_p = 0.0259x200 = 5.18cm^2/s$

四、(14分) 考虑硅突变 PN 结二极管,已知 $N_D=10^{16}$ cm⁻³ 和 $N_A=5$ x 10^{15} cm⁻³,假设 温 T=300K,

- 1、计算内建电势 φbi;
- 2、计算耗尽层宽度(Wdep)以及耗尽层在 N 型区和 P 型区的宽度(xn 和 xp);
- 3、计算最大电场强度;
- 4、画出能带图、电势分布图、电场分布图。

本题得分

求解:

$$\phi_{bi} = \left(\frac{kT}{q}\right) \ln\left(\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right) = (0.026 V) \times \ln\left(\frac{\left(10^{16} cm^{-3}\right) \times \left(5 \times 10^{15} cm^{-3}\right)}{\left(10^{10} cm^{-3}\right)^2}\right) = 0.7 V$$
1:

2:

$$W_{dep} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{s}\phi_{ls}}{q} \left(\frac{1}{N_{a}} + \frac{1}{N_{d}}\right)}$$

$$= \sqrt{\frac{2 \times 12 \times \left(8.85 \times 10^{-14}\right) \times 0.7}{1.6 \times 10^{-19}} \times \left(\frac{1}{10^{16}} + \frac{1}{5 \times 10^{15}}\right)}$$

$$= 5.28 \times 10^{-5} cm$$

$$= 0.528 \mu m$$

$$= 528 nm$$

$$x_{n} = W_{dep} - x_{p} = W_{dep} - \frac{N_{d}}{N_{u}} x_{n}$$

$$\therefore x_{n} = \left(\frac{N_{a}}{N_{a} + N_{d}}\right) W_{dep} = \left(\frac{5 \times 10^{15} \, cm^{-3}}{(5 \times 10^{15} \, cm^{-3}) + (10^{16} \, cm^{-3})}\right) \times (0.528 \, \mu m) = 0.176 \, \mu m$$

$$x_{p} = \left(\frac{N_{d}}{N_{a} + N_{d}}\right) W_{dep} = \left(\frac{10^{16} cm^{-3}}{\left(5 \times 10^{15} cm^{-3}\right) + \left(10^{16} cm^{-3}\right)}\right) \times (0.528 \, \mu m) = 0.352 \, \mu m$$

3:

$$\mathcal{E}_{max} = \frac{qN_d x_n}{\varepsilon_s} = \frac{(1.6 \times 10^{-19} \, \text{C}) \times (10^{16} \, \text{cm}^{-3}) \times (1.76 \times 10^{-5} \, \text{cm})}{12 \times (8.85 \times 10^{-14} \, \text{F/cm})} = 2.652 \times 10^4 \, \text{V/cm}$$

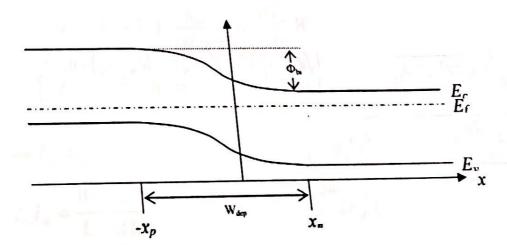
或

$$\phi_{bi} = \frac{1}{2} W_{dep} \mathcal{E}_{max}$$

$$\therefore \mathcal{E}_{max} = \frac{2\phi_{bi}}{W_{dep}} = \frac{2 \times (0.7V)}{5.28 \times 10^{-5} cm} = 2.652 \times 10^{4} V / cm$$

4:

(1) 能带图

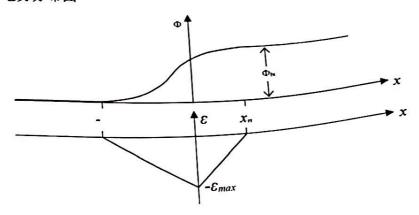


1. 花板: 羊椒瓜

4. 肖特圣花

5. 装伏电

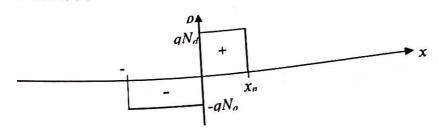
(2) 电势分布图



$\sqrt{\phi_1} = \frac{-\sqrt{2qN_o \varepsilon_1}}{2C_{ox}} + \sqrt{\frac{2c}{2C_{ox}}}$



(3) 电场分布图



(c)

五、 $(12\,
m 分)$ 当 MOS 电容栅压 $V_g>V_p$,半导体表面会出现耗尽,其耗尽层宽度为

氧化层两侧压降可表示为 $V_{ox} = -\frac{Q_{sub}}{C_{ox}} = -\frac{Q_{dep}}{C_{ox}} = \frac{qN_aW_{dep}}{C_{ox}} = \frac{\sqrt{qN_a2\varepsilon_s\phi_s}}{C_{ox}}$,其中

$$\phi_s = \frac{q N_a W_{dep}^2}{2\varepsilon_s} \, .$$

本题得分

- (a) 请将 ϕ_s 写成 V_g 的函数表达式;
- (b) 推导 $V_{\alpha x}$ 作为 V_{g} 的函数表达式;
- (c) 将 W_{dep} 写成 V_g 的函数表达式。

求解: (a)

$$V_{g} = V_{fb} + \phi_{s} + \frac{1}{C_{ox}} \sqrt{2qN_{a}\varepsilon_{s}\phi_{s}} \qquad (\sqrt{\phi_{s}})^{2} + \left(\frac{\sqrt{2qN_{a}\varepsilon_{s}}}{C_{ox}}\right)\sqrt{\phi_{s}} + (V_{fb} - V_{g}) = 0.$$

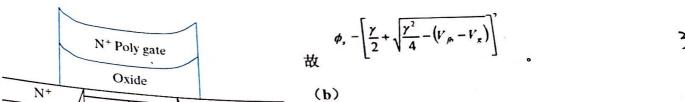
$$\sqrt{\phi_{s}} = \frac{-\frac{\sqrt{2qN_{a}\varepsilon_{s}}}{C_{ox}} \pm \sqrt{\frac{2qN_{a}\varepsilon_{s}}{C_{ox}^{2}} - 4(V_{fb} - V_{g})}}{2}.$$
For TMF

$$\left(\sqrt{\phi_s}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2qN_a\varepsilon_s}}{C_{ox}}\right)\sqrt{\phi_s} + \left(V_{fb} - V_g\right) = 0$$

取正根

1. 龙

$$\sqrt{\phi_s} = \frac{-\sqrt{2qN_a\varepsilon_s}}{2C_{\alpha x}} + \sqrt{\frac{2qN_a\varepsilon_s}{4C_{\alpha x}^2} - \left(V_{fb} - V_g\right)} = \frac{\gamma}{2} + \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} - \left(V_{fb} - V_g\right)} \qquad \qquad \gamma = \frac{\sqrt{2qN_a\varepsilon_s}}{C_{\alpha x}} \; . \label{eq:phi_sigma}$$



Oxide
$$\begin{array}{c|c}
 & & & \\
 & N^{+} & & \\
 & -L/2 & 0 & L/2 \\
 & P-substrate
\end{array}$$

$$V_{\text{ox}} = \frac{\sqrt{2qN_a\varepsilon_s}}{C_{\text{ox}}}\sqrt{\phi_s} = \gamma \left[\frac{\gamma}{2} + \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} - (V_{\text{fb}} - V_{\text{g}})}\right].$$

(c)

$$W_{dep} = \frac{\sqrt{2q\varepsilon_s}}{C_{ax}} \sqrt{\phi_s} = \frac{\sqrt{2q\varepsilon_s}}{C_{ax}} \left[\frac{\gamma}{2} + \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} - (V_{fb} - V_g)} \right].$$

六、 $(12 \, f)$ 一个 NMOSFET 的 T_{ox} 在沟道中心更薄,而在源漏处较厚,参见下图。其厚度的分布可以近似表示为 $T_{ox}=Ax^2+B$ 。假定阈值电压 V_t 与 x 无关,且 m=1 (不考虑速度饱和)。

(a)推导出源漏电流 Ia 的表达式;

(b)推导出饱和漏极电压 Vdsat 的表达式;

求解: (a)

$$I_{d} = -Q_{n}\mu_{n} \frac{dV_{c}}{dx}W = (V_{g} - V_{t} - V_{c})C_{ox}(x)\mu_{n} \frac{dV_{c}}{dx}W$$

$$= (V_{g} - V_{t} - V_{c}) \frac{\varepsilon_{ox}}{Ax^{2} + B}\mu_{n} \frac{dV_{c}}{dx}W$$

$$\therefore \int_{-L/2}^{L/2} I_{d} \cdot (Ax^{2} + B)dx = \int_{0}^{V_{d}} (V_{g} - V_{t} - V_{c})\varepsilon_{ox}\mu_{n}WdV_{c}$$

$$\Rightarrow I_{d} \cdot \left[\frac{A}{3}x^{3} + Bx\right]_{-L/2}^{L/2} = \varepsilon_{ox}\mu_{n}W[(V_{g} - V_{t})V_{c} - 1/2V_{c}^{2}]_{0}^{V_{ds}}$$

$$\therefore I_{d} = \frac{W}{L} \cdot \frac{\varepsilon_{ox}\mu_{n}}{\frac{AL^{2}}{12} + B} \cdot \left[(V_{g} - V_{t})V_{ds} - 1/2V_{ds}^{2}\right]$$

(b)

当
$$\frac{\partial I_d}{\partial V_{ds}}|_{V_x} = 0$$
 时,有 $V_{dsat} = V_d$,故 $V_{dsat} = V_g - V_t$

七、(12分) 假设 N*多晶硅栅和 P型衬底之间的栅氧化层厚度为 1.1 nm, 且 本题得么 $N_a = 1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$.

- (c) 假设 $V_z=V_i$ 时, $I_{di}=100W/L(nA)$,当 $W=1\mu m$, $L=18\,nm$,最大漏电流是3人

求解:

- (a) $C_{0x}=3.45 \times 10^{-13}/1.1 \times 10^{-7}=3.138 \mu F/cm^2$ V_{t} =-1.04+0.95+ Q_{dep}/C_{ox} =-1.04+0.95+0.18=0.109V
- (b) $S=60(1+C_{dep}/C_{6x})=60(1+2.953\times10^{-7}/3.138\times10^{-6})=65.64\text{mV/dec}$
- (c) 1/S=[log(W/Lx100nA)-log(Ileakage)]/Vt

Ileakage=121nA

八、(14分) 考虑如下图所示的 PNP BJT 的过剩载流子分布 (图中耗尽区已省略, 显示中性区中的少子分布)。假设产生-复合电流成分都可忽略,且每个区域均为物 杂。已知扩散系数 D_n=30 cm²/s 和 D_p=10 cm²/s, 且器件的横截面积为 10-5 cm²,发颖 杂浓度为 N_E=10¹⁸cm-3。 本题得分

- (a) 求出集电区掺杂浓度 Nc;
- (b) 该 BJT 工作在什么状态?
- (c) 计算基区存储的过剩载流子电荷总量 Q;
- (d) 求出发射极电流 IE;
- (e) 当 VEB>0.7 V, VCF>0.3 V, 且不考虑基区宽度的调制效应, 计算 BJT 工作在非领 区的共发射极电流增益 BF

求解: (a)N (b)由于 B

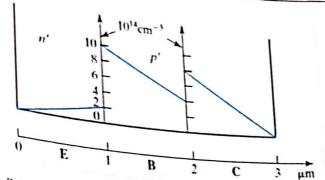
(c)

 $Q = \frac{1}{2}$

(d)

IE





求解: (a) $N_B/N_C=n'/p'$, $N_E/N_B=p'/n'$ 故 $N_E/N_C=10$, $N_C=0.1N_E=10^{17}$ cm⁻³ (b)由于 BE, BC 结正偏,该 BJT 处于饱和态。

(c)

$$Q = \frac{Aq}{2} [p'(x = 1\mu m) + p'(x = 2\mu m)] W_B =$$

$$= 10^{-5} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 0.5 \times 14 \times 10^{14} \times 10^{-4} = 1.12 \times 10^{-13} \text{ coul }.$$

(d)

$$I_{E} = I_{nE} + I_{pE} =$$

$$= Aq[D_{n} \frac{n'(x = 1\mu m) - n'(x = 0\mu m)}{W_{E}} + D_{p} \frac{p'(x = 1\mu m) - p'(x = 2\mu m)}{W_{B}}] =$$

$$= 10^{-5} \times 1.6 \times 10^{-19} \times \left[30 \left(\frac{2 \times 10^{14}}{1 \times 10^{-4}} \right) + 10 \left(\frac{6 \times 10^{14}}{1 \times 10^{-4}} \right) \right] mA = 0.192 mA.$$

(e)

$$\beta = \frac{D_B W_E N_E}{D_E W_B N_B} = \frac{10 \times 10^{-4} \times N_E}{30 \times 10^{-4} \times N_B} = \frac{1}{3} \times 1 \times 5 = \frac{5}{3} = 1.7$$